

Dell PowerEdgeラック サーバーは、ITの課題を最小限に抑え、ビジネスの成功を促進するモダン インフラストラクチャの構築を支援します。『クイック リファレンス ガイド(QRG)』には、当社のラック サーバーの全ポートフォリオが凝縮されています。

ラック サーバー	R760	R660	R7625	R6625	R7615	R6615
主要な特性	要求の高いアプリケーションでパフォーマンスと汎用性を実現	要求の高いアプリケーションでパフォーマンスと汎用性を実現	画期的なパフォーマンス	画期的なパフォーマンス	強力なパフォーマンスと拡張性	最高のパフォーマンスと優れたTCO
ターゲットワークロード	混在ワークロードの標準化データベースと分析、仮想デスクトップ インフラストラクチャ	高密度仮想化、高密度データベース分析、混在ワークロードの標準化	ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、仮想デスクトップ インフラストラクチャ(VDI)、仮想化	ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、仮想デスクトップ インフラストラクチャ(VDI)、仮想化	ソフトウェア定義ストレージ(SDS)、仮想化、データ分析	仮想化、ハイパーコンバージド インフラストラクチャ(HCI)、ネットワーク機能仮想化(NFV)
プロセッサのタイプ	2 x 第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサあたり最大56コア)		2 x AMD EPYC™第4世代9004シリーズ プロセッサ (プロセッサあたり最大96コア)		1 x AMD EPYC™第4世代9004シリーズ プロセッサ (最大96コア)	
メモリー (DDR5 DIMMスロットと最大容量)	32 (8 TB)		24 (1.5 TB)*		12 (768 GB)*	
ディスクドライブの最大数:	3.5インチ x 12 2.5インチ x 8 2.5インチ x 16 2.5インチ x 24 2 x 2.5インチまたは 4 x 2.5インチ (背面)	2.5インチ x 8 2.5インチ x 10 2.5インチ x 2 (背面)	3.5インチ x 8 3.5インチ x 12 2.5インチ x 8 2.5インチ x 16 2.5インチ x 24 2 x 2.5インチまたは 4 x 2.5インチ (背面)	3.5インチ x 4 2.5インチ x 8 2.5インチ x 10 2.5インチ x 2 (背面)	3.5インチ x 8 3.5インチ x 12 2.5インチ x 8 2.5インチ x 16 2.5インチ x 24 2 x 2.5インチまたは 4 x 2.5インチ (背面)	3.5インチ x 4 2.5インチ x 8 2.5インチ x 10 2.5インチ x 2 (背面)
NVMeドライブの最大数:	24	10	24	10	24	10
Gen5 PCIeスロットの最大数:	4	2	4	2	4	2
Gen4 PCIeスロットの最大数:	8	3	8	3	4	3
アクセラレーターサポートの最大数:	2 x 350 W DWまたは6 x 75 W SW	2* x 75 W SW	2 x 300 W DWまたは6 x 75 W SW	75 W SW x 3	3 x 300 W DWまたは6 x 75 W SW	75 W SW x 3
ラックの高さ (U)	2	1	2	1	2	1
セキュリティ機能の統合	TPM 2.0 FIPS、CC-TCG認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャード インテリジェント アラート、標準セキュリティとしてのセキュアブート、シリコン ルート オブ トラスト、System Lockdown (iDRAC9 EnterpriseまたはDatacenterが必要)、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理を使用したSED)、すべてのラックでのセキュアなコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック) およびSystem Erase。			TPM 2.0 FIPS、CC-TCG認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、セキュアブート、セキュア消去、シリコン ルート オブ トラスト、System Lockdown (iDRAC9 EnterpriseまたはDatacenterが必要)、AMDセキュア メモリー暗号化(SME)、AMDセキュア暗号化仮想化(SEV)		












* 今後のリリースでは、R7625、R6625、R7615、R6615のDIMM容量が追加される予定です。

* 今後のリリースでは、R660にGPUスロットが追加される予定です。

Dell PowerEdgeラック サーバー

クイックリファレンスガイド

ラック サーバー	R750	R750xa	R650	R7525	R6525	R7515	R6515	R750xs	R650xs	R450	R550	XR11	XR12	R350	R250
主要な特性	最も要求の厳しいワークロードに対する優れたパフォーマンス	高集約型のGPUワークロード	高い拡張性、最適化されたワークロードパフォーマンス	強力なパフォーマンスと柔軟性	高密度な仮想化	強力なパフォーマンスと拡張性	高密度なコンピューティング	拡張性のあるスケールアウトソリューション向けに構築された2Uサーバー	高密度かつ急増するスケールアウトソリューション向けに構築されたフルパフォーマンスの1Uサーバー	価値と密度に重点を置き、汎用IT向けに構築	汎用性、最適な価値、仮想化対応性を備え、汎用IT向けに構築	逆取り付けオプションを備え、エッジ中心、短い奥行きで堅牢	逆取り付けオプションを備え、エッジ中心、短い奥行きで堅牢	生産性とデータ集約型アプリケーションにおいてパワフルなパフォーマンスの1Uサーバー	一般的なビジネスアプリケーション向けのパワフルなコンピューティングと生産性の合理化
ターゲットワークロード	データベースと分析、HPC、従来の企業IT、VDI、AI、MLの環境	AI、ML、DLのトレーニングと推論、HPC、仮想化の環境	混在ワークロードの標準化、データベースと分析、HFT、従来の企業IT、VDI、HPC、AI、またはMLの環境	オールフラッシュ SDS、VDI、データ分析	HPC、高密度 VDI、仮想化	SDS、仮想化、データ分析	仮想化、HCI、NFV	仮想化、中程度のVM密度またはVDI、スケールアウトデータベースのワークロード	仮想化、クラウド、スケールアウトデータベース、ハイパフォーマンス コンピューティングワークロード	小規模ITインフラストラクチャ、小規模VM、スモールビジネス固有のワークロード	小規模ITインフラストラクチャ、低VM密度、スモールビジネス固有のワークロード	電気通信/5G (MEC、CDN、vRAN)、軍用、小売店舗 (分析: ビデオ監視/POS/IOT集計)	電気通信/5G (MEC、CDN、vRAN)、軍用、小売店舗 (分析: ビデオ監視/POS/IOT集計)	中小企業、リモートオフィス/支社、コラボレーションと共有、データ分析、仮想化ワークロード	中小企業、リモートオフィス/支社、コラボレーションと共有、メール/メッセージング、ファイル/印刷ワークロード
プロセッサのタイプ	2 x 第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大40コア)			第2世代または第3世代AMD EPYC™プロセッサ x 2 (プロセッサごとに最大64コア)		第2世代または第3世代AMD EPYC™プロセッサ x 1 (プロセッサごとに最大64コア)		第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大32コア) x 2		第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大24コア) x 2		第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大36コア) x 1		インテル Xeon E-2300シリーズ プロセッサ x 1 (最大8コア) またはインテルPentiumプロセッサ x 1 (最大2コア)	
メモリー (DDR4 DIMMスロットと最大容量)	32 (8 TB)		32 (4 TB)			16 (2 TB)			16 (1 TB)			8 (1 TB)		4 (128 GB)	
ディスクドライブの最大数:	2.5インチ x 8 2.5インチ x 16 2.5インチ x 24 3.5インチ x 12 2.5インチ x 2または2.5インチ x 4 (背面)	2.5インチ x 6 2.5インチ x 8	3.5インチ x 4 2.5インチ x 8 2.5インチ x 10 2.5インチ x 2 (背面)	2.5インチ x 26 3.5インチ x 12	2.5インチ x 12 3.5インチ x 4	2.5インチ x 24 3.5インチ x 12	2.5インチ x 8 3.5インチ x 4	2.5インチ x 8 2.5インチ x 16 2.5インチ x 24 3.5インチ x 12 3.5インチ x 8	3.5インチ x 4 2.5インチ x 8 2.5インチ x 10 2.5インチ x 2 (背面)	3.5インチ x 4 2.5インチ x 8	2.5インチ x 16 2.5インチ x 8 3.5インチ x 8	2.5インチ x 4	2.5インチ x 6	3.5インチ x 4 2.5インチ x 8	3.5インチ x 4 2 x 3.5インチ (ケーブル接続) 4 x 3.5インチ (ケーブル接続)
NVMeドライブの最大数:	24	8	12	24	12	24	10	8	10	該当なし		4	6	該当なし	
Gen4 PCIeスロットの最大数:	8	8	3	8	3	2	1	5	3	2	3	3	5	3	2
Gen3 PCIeスロットの最大数:	該当なし					2	1	1	該当なし		1	該当なし			
アクセラレーターサポートの最大数:	300 W DW x 2、または150 W SW x 4または75 W SW x 6	150 W SW x 4または300 W DW x 4または75 W SW x 2	75 W SW x 3	300 W DW x 3、または75 W SW x 6	SW x 3	SW x 4; DW x 1; FPGA x 1	1 x SW	該当なし				75 W SW x 2	75 W x 2または150 W SW 300 W DW x 2	該当なし	
ラックの高さ (U)	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
セキュリティ機能の統合	TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG認定、TPM 2.0中国NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャーン侵入アラート、セキュアブートが、すべてのラックにおいて標準のセキュリティ機能になっています。シリコンルート オブ トラスト、System Lockdown (iDRAC9 EnterpriseまたはDatacenterが必須)、System Eraseなどの統合されたセキュリティ機能がすべてのラックにおいて標準														

ラック サーバー	R940	R940xa	R840	R740xd	R740	R740xd2	R640	R540	R440	R340	R240
主要な特性	 強力なパフォーマンス	 究極の高速化	 さらに高速になったデータ分析	 拡張性のあるストレージパフォーマンス	 最適アプリケーションパフォーマンス	 エンタープライズ コンテンツサーバー	 パフォーマンスと密度	 バランスと適応性	 スケールアウトコンピューティング	 ビジネスの成長を加速	 シンプルさを追求したコンピューティング
ターゲットワークロード	インメモリ データベース	GPUデータベースの高速化と機械学習	データ集約型ワークロード、HFT、高密度の仮想化	SDS、サービス プロバイダー、Big Dataサーバー	VDIとクラウド ワークロード	メディア ストリーミングとSDS	スケールアウト データ センターの高密度なコンピューティングとストレージ	メール メッセージングと仮想化	HPC、Webテクノロジー、スケールアウト インフラストラクチャ	ROBOの生産性とデータ集約型アプリケーション	スモール ビジネスおよびサービス プロバイダーのワークロード
プロセッサのタイプ	第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ x 4			第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ x 2						インテル Xeon E-2200、インテル Core i3®、インテル Pentium®、またはインテルCeleron® プロセッサ x 1	
メモリー (DDR4 DIMMスロットと最大容量)	48 (15.36 TB)			24 (7.68 TB)			16 (1 TB)	24 (7.68 TB)	16 (1 TB)		4 (64 GB)
ディスクドライブの最大数:	2.5インチ x 24	2.5インチ x 32	2.5インチ x 26	2.5インチ x 32 3.5インチ x 18	2.5インチ x 16 3.5インチ x 8	3.5インチ x 26 3.5インチ x 16 + 2.5インチ x 10 ²	2.5インチ x 12 3.5インチ x 4	3.5インチ x 14	2.5インチ x 10 3.5インチ x 4	2.5インチ x 8 3.5インチ x 4	2.5インチ x 4 ² 3.5インチ x 4
NVMeドライブの最大数:	12	4	24	該当なし		10	該当なし		4	該当なし	
Gen4 PCIeスロットの最大数:	該当なし										
Gen3 PCIeスロットの最大数:	13	12	6	8		5	3	5	2	2	
アクセラレーター サポートの最大数:	該当なし	DW GPU x 4または DW x 4または SW FPGA x 8	DW GPU x 2または SW x 2または DW FPGA	DW x 3または SW GPU x 6または DW x 3または SW FPGA x 4		該当なし	SW GPU x 1または SW FPGA x 1	該当なし			
ラックの高さ (U)	3	4	2					1	2	1	1
セキュリティ機能の統合	TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG認定、TPM 2.0中国NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャード侵入アラート、セキュアブートが、すべてのラックにおいて標準のセキュリティ機能になっています。シリコン ルート オブ トラスト、System Lockdown (iDRAC9 EnterpriseまたはDatacenterが必須)、System Eraseなどの統合されたセキュリティ機能がすべてのラックで標準になっています。										

¹すべての機能をすべてのプラットフォームで利用できるわけではありません。

²ドライブではハイブリッド キャリアーを使用し、3.5インチ ドライブ ベイに収まります。(R740xd2では、最大10台の2.5インチSSDでハイブリッド構成が利用可能です)

ゼロトラストIT環境および運用のためのサイバー レジリエント アーキテクチャ

セキュリティは、保護されたサプライチェーンや工場からサイトへの信頼性保証など、PowerEdgeライフサイクルのすべての段階に統合されています。シリコンベースのルートオブトラストはエンドツーエンドのブートレジリエンスを支え、多要素認証(MFA)とロールベースのアクセス制御により、信頼できる運用を実現します。

サステナビリティ

PowerEdgeポートフォリオは、製品とパッケージへのリサイクル素材の使用から、エネルギー効率を検討した革新的なオプションに至るまで、二酸化炭素排出量の削減と運用コストの削減に役立つ製品の製造、提供、リサイクルを目的として設計されています。さらに、Dell Technologies Servicesにより、責任を持ってレガシーシステムを簡単に廃棄することもできます。

自律型インフラストラクチャによって効率性を向上させ、運用を加速

Dell OpenManage™ Systems Managementポートフォリオは、PowerEdgeサーバー向けの安全で効率的で包括的なソリューションを提供します。OpenManage EnterpriseコンソールとiDRACにより、1対多の管理をシンプル化、自動化、一元化します。OpenManage Enterprise Power Managerを使用すると、電力使用量をモニタリングすることで、データセンターレベルの冷却効率から真のメリットを得ることができます。サーバーの温度を管理できるようになると、エネルギーの無駄を減らし、機器の摩耗や損傷を減らして、投資の活用年数を延ばすことができます。

Dell Technologies Servicesでサーバーを安心して活用

コンサルティング、ProDeploy、ProSupport suites、データ移行など、170か所で利用可能で、6万人以上の従業員とパートナーが支援する包括的なサービスにより、PowerEdgeサーバーを最大限に活用できます。

PowerEdgeサーバーに関する詳細についてもっと知るには



PowerEdgeサーバー
についての詳細情報



Dellのシステム管理
ソリューションについての
詳細情報



Dellのリソース
ライブラリーを検索



TwitterでPowerEdge
サーバーをフォロー



セールスまたはサポート
についてはデル・テクノ
ロジーズのエキスパートにお
問い合わせください



LinkedInでPowerEdge
サーバーをフォロー